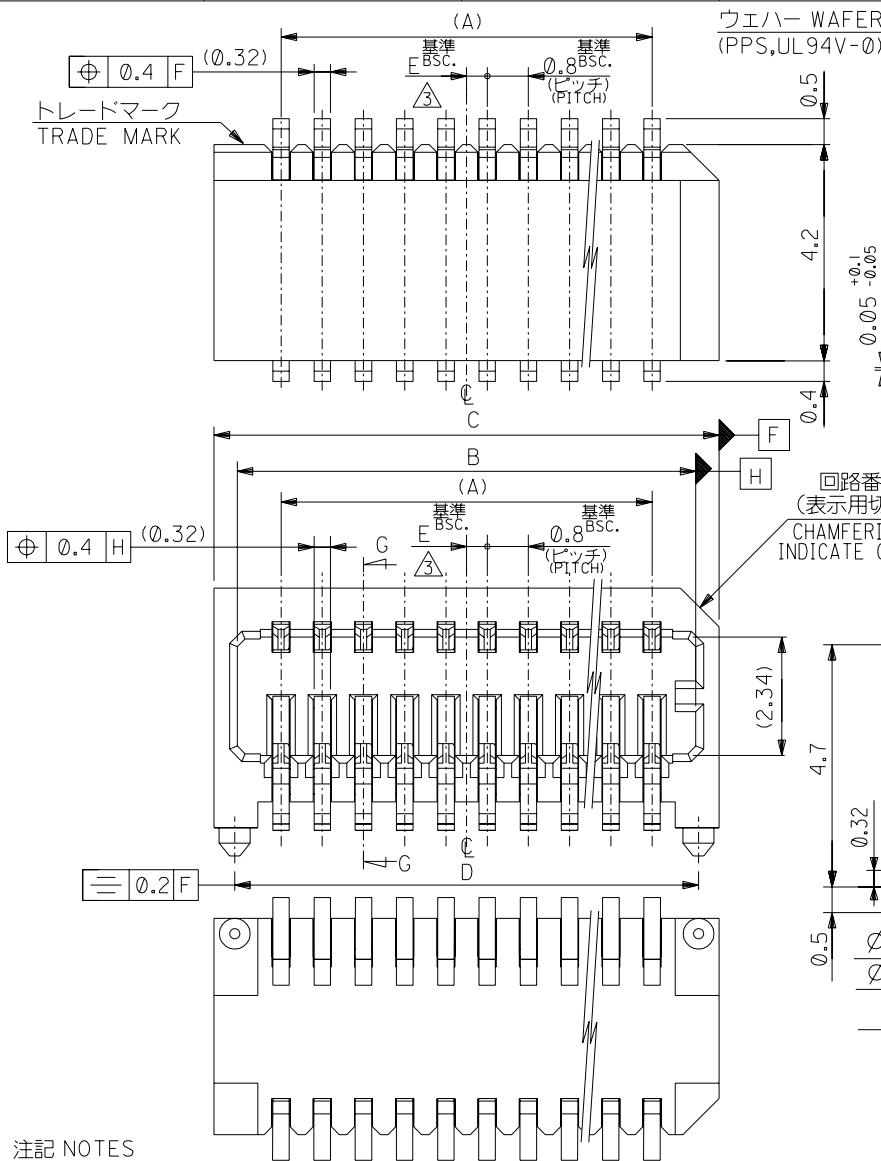
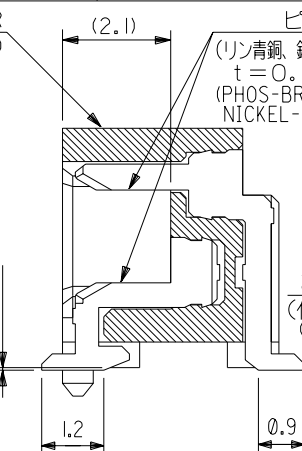




注記 NOTES

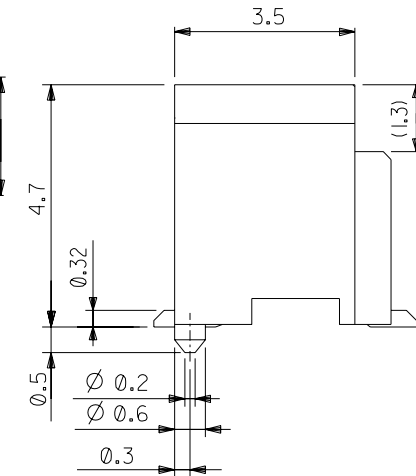
1. 嵌合相手: 52465, 52588 シリーズ
MATE WITH: 52465, 52588 SERIES
2. ウェハの ④ から隣接するピンの ④ 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM ④ OF WAFER TO ④ OF ADJACENT PINS.
3. 本製品は 53309-***17 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53309-***17.

ウェハー WAFER
(PPS, UL94V-0)



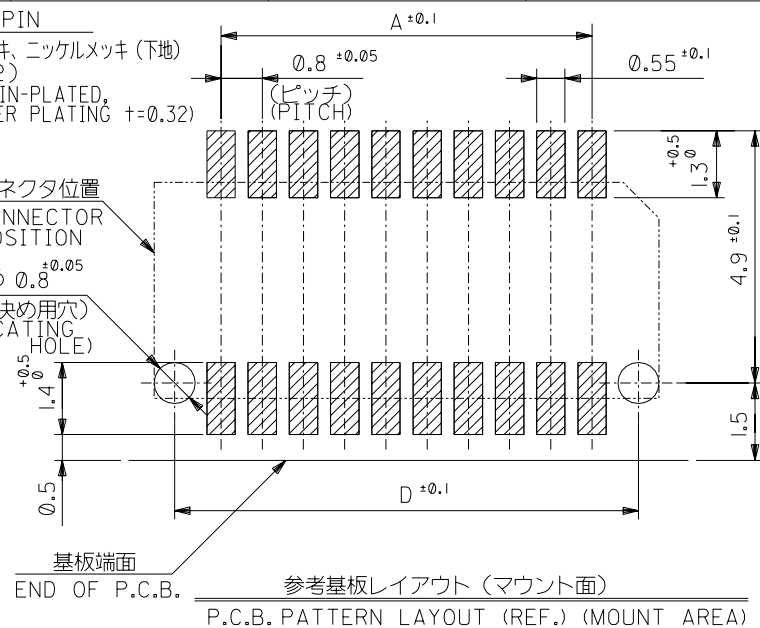
SECT. G-G

回路番号 1
(表示用切欠き)
CHAMFERING TO
INDICATE CKT. NO.1



ピン PIN
(リン青銅, 錫メッキ, ニッケルメッキ (下地)
t=0.32)
(PHOS-BRO. TIN-PLATED,
NICKEL-UNDER PLATING t=0.32)

コネクタ位置
CONNECTOR POSITION
2-φ0.8
(位置決め用穴)
(LOCATING HOLE)



0.4	17.0	17.8	16.9	15.2	53309-4019	40
0.8	16.2	17.0	16.1	14.4	-3819	38
0.4	15.4	16.2	15.3	13.6	-3619	36
0.8	14.6	15.4	14.5	12.8	-3419	34
0.4	13.8	14.6	13.7	12.0	-3219	32
0.8	13.0	13.8	12.9	11.2	-3019	30
0.4	12.2	13.0	12.1	10.4	-2819	28
0.8	11.4	12.2	11.3	9.6	-2619	26
0.4	10.6	11.4	10.5	8.8	-2419	24
0.8	9.8	10.6	9.7	8.0	-2219	22
0.4	9.0	9.8	8.9	7.2	-2019	20
0.8	8.2	9.0	8.1	6.4	-1819	18
0.4	7.4	8.2	7.3	5.6	-1619	16
0.8	6.6	7.4	6.5	4.8	-1419	14
0.4	5.8	6.6	5.7	4.0	-1219	12
0.8	5.0	5.8	4.9	3.2	53309-1019	10

53309-***19
MODEL NO.

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY '04/03/10 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/10 K.TOJO
APP'D BY '04/03/10 M.SASAO	尺度 SCALE —#—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称 0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT (WITH BOSS) -LEAD FREE-
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV SD-53309-013 0

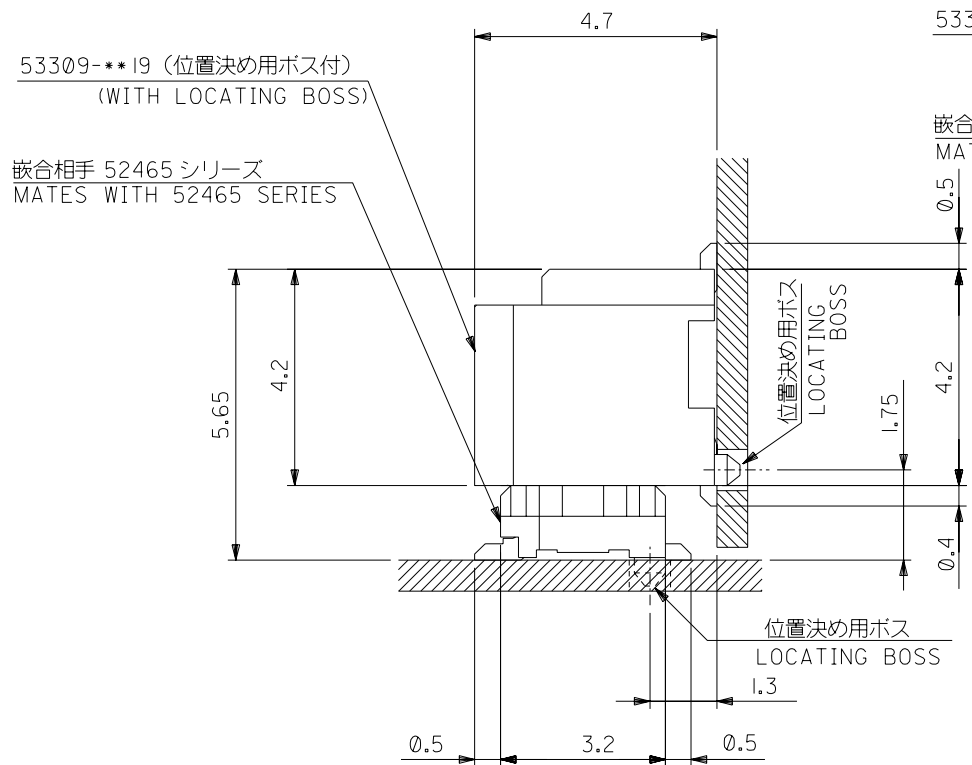
角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

DWG. NO.
SD-53309-013

E

D

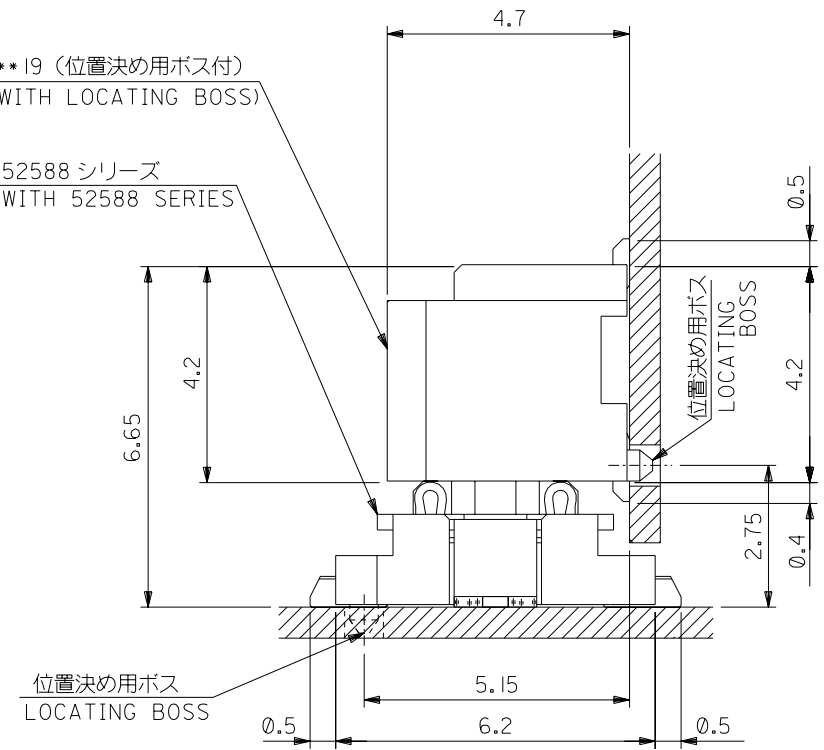
C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)

53309-***I9 (位置決め用ボス付)
(WITH LOCATING BOSS)

嵌合相手 52588 シリーズ
MATES WITH 52588 SERIES



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)

				MODEL NO.		53309-***I9
				材料 MATERIAL		
				SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		
				仕上げ FINISH		
				適用電線範囲 WIRE RANGE		
				被覆外径 INS. RANGE		
				DRAWN BY '04/03/10 H.KAWABATA		
				CHK'D BY '04/03/10 K.TOJO		
				APP'D BY '04/03/10 M.SASAO		
				尺度 SCALE		
				TITLE 名称 0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT (WITH BOSS) -LEAD FREE-		
				DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53309-013 0		
				新規作成 RELEASED (2004-3005)		
				変更内容 REVISION RECORD		
				日付 DATE		
				記号 LTR		
				一般公差 GENERAL TOLERANCES		
				角度 ANGLE		
				30 以上 OVER		
				10 以上 30 未満 OVER 30 UNDER		
				未満 10 UNDER		

8

7

6

5

4

3

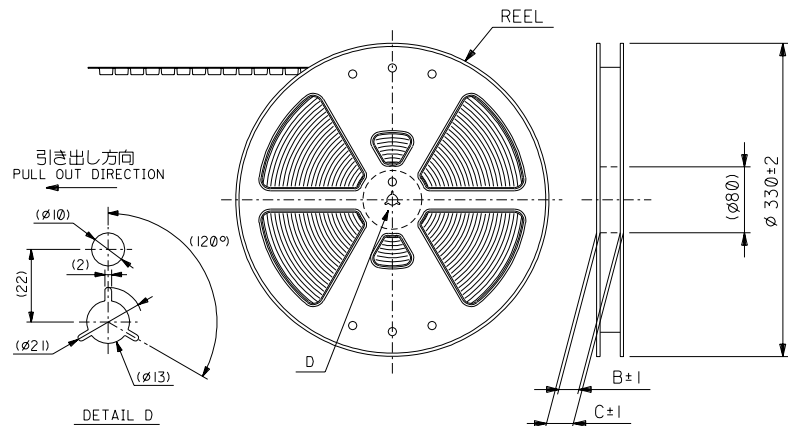
2

1

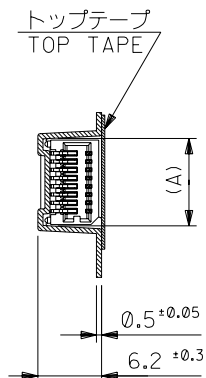
注記 NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL

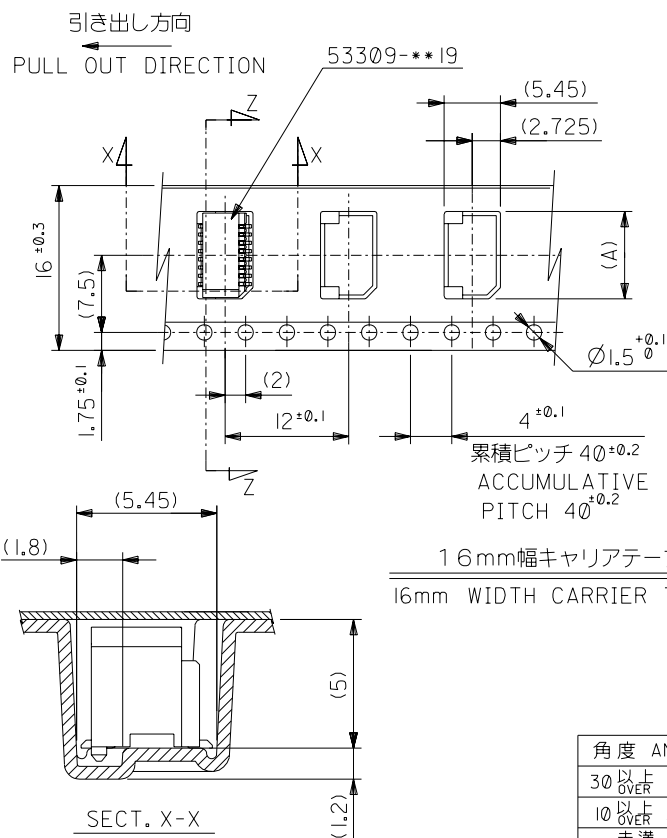
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PARTトップテープ TOP TAPE
未接着部 NON-BONDED PART

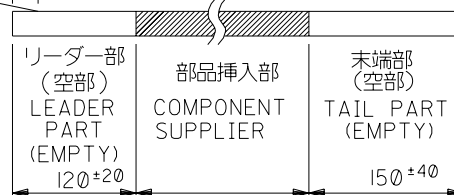
DETAIL D



SECT. Z-Z



SECT. X-X

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

0.1~1.3N {10~130gf} 尚、本規格値は、出荷時に適用。

(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

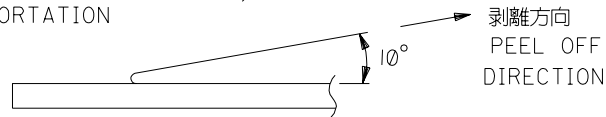
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE

0.1~1.3N {10~130gf} (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,

DURING TRANSPORTATION

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

5. 材料(MATERIAL)

キャリアテープ(CARRIER TAPE): ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)

トップテープ(TOPTAPE): PET, PE, PEF

リール(REEL): ポリスチレン(PS) <リサイクル材を含む>

POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6. 本製品は53309-014の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53309-014.

53309-014
MODEL NO.キャリアテープ幅
CARRIER TAPE WIDTH

C

B

(A)

MATERIAL NO.

極数
CIRCUIT材料
MATERIAL注記参照
SEE NOTESMOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社仕上げ
FINISH

—

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

適用電線範囲
WIRE RANGE

—

TITLE 名称

被覆外径
INS. RANGE

—

0.8 BtB Conn Wafer Assy

DRAWN BY '04/03/10
H.KAWABATACHK'D BY '04/03/10
K.TOJO

RA SMT With Boss

APP'D BY '04/03/10
M.SASAO尺度
SCALE

—

-LEAD FREE-

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.5
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号
LTR新規作成
RELEASER変更内容
REVISION RECORDDR.
CHK.日付
DATE

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

04/03/10

8

7

6

5

4

3

2

1

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

53309-**-19

$1.5^{+0.1}$

(5.45)

(2.725)

$+0.15$
 -0.2

$0.2^{+0.15}$
 -0.2

$W/4$

Z

W

32 ± 0.3

28.4 ± 0.1

(14.2)

(A)

$\phi 1.5^{+0.1}$
 -0.0

(2)

12 ± 0.1

4 ± 0.1

累積ピッチ 40 ± 0.2
ACCUMULATIVE PITCH 40 ± 0.2

					MATERIAL	SHEET 1 OF 2参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
					仕上げ FINISH	--#--	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
					適用電線範囲 WIRE RANGE	--#--	TITLE 名称 0.8 BtB Conn Wafer Assy RA SMT With Boss Embstp Pkg -LEAD FREE-
					被覆外径 INS. RANGE	--#--	DWG.NO.(SHEET 2 OF 2)
					DRAWN BY'04/03/10 H.KAWABATA	CHEK'D BY '04/03/10 K.TOJO	REV
					APP'D BY '04/03/10 M.SASAO	R SCALE --#-- SD-53309-014	
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	日付 DATE			
①	新規作成 (JZ0004-30065) RELEASED	H.K.	K.T.	'04/03/10			0

SD-53309-014.S02